第３６回春季講演大会プログラム（３月２３日から２５日）

プログラムNO	日時	開始時間	終了時間	分野	著者	所属	演題名
23A1-01	3月23日	9:00	9:15	サーマルマネージメント＆パワーエレクトロニクス実装	北村駿[1]山田靖[1]竹馬克洋[2]俊成修平[2]	大同大学[1],株式会社サーモグラフィティクス[2]	メッキプロセスによるパワーデバイス用銅柱グラファイト放熱板
23A1-02	3月23日	9:15	9:30	サーマルマネージメント＆パワーエレクトロニクス実装	齋藤晃太, 畠山友行, 木伏理沙子, 石塚勝	富山県立大学	水冷式ピンフィン型ヒートシンクの冷却性能評価のための熱回路モデル構築に関する基礎検討
23A1-03	3月23日	9:30	9:45	サーマルマネージメント＆パワーエレクトロニクス実装	佐藤克哉, 矢尾板明子, 山本哲也	株式会社東芝　生産技術センター	熱負荷の可視化技術を用いたパワーサイクル試験時のひずみの解析精度向上
23A1-04	3月23日	9:45	10:00	サーマルマネージメント＆パワーエレクトロニクス実装	中村裕介	富山県立大学	定常法熱抵抗計測における熱損失が測定精度に与える影響
23A2-01	3月23日	10:20	10:35	サーマルマネージメント＆信頼性解析技術	谷澤秀和[1],宝蔵寺裕之[2],加藤史樹[2],佐藤嘉洋[1],佐藤弘[2]	サンケン電気株式会社[1],産業技術総合研究所[2]	大面積接合劣化検出技術
23A2-02	3月23日	10:35	10:50	サーマルマネージメント＆信頼性解析技術	田中聡[1],新開次郎[1],宝蔵寺裕之[1],加藤史樹[1],池川正人[1],佐藤弘[1],倉島宏美[2]	産業技術総合研究所[1],住友電気工業株式会社[2]	225℃動作SiCモジュールのパワーサイクル長寿命化
23A2-03	3月23日	10:50	11:05	サーマルマネージメント＆信頼性解析技術	林雄二郎,KimJaemyung,矢橋牧名	理化学研究所	放射光X線を用いたはんだの非破壊方位マッピング
23A2-04	3月23日	11:05	11:20	サーマルマネージメント＆信頼性解析技術	首藤高徳[1],園田正樹[1],上野竜太[1],本田さほ[1],橋口智和[1],杉木昭雄[2],橋本博典[2],梅木誠[2]	大分県産業科学技術センター[1],大分デバイステクノロジー株式会社[2]	Cu-Sn系IMC接合材を用いたパワーモジュールの信頼性評価
23B1-01	3月23日	9:00	9:30	部品内蔵技術	加藤義尚	福岡大学半導体実装研究所	部品内蔵基板を用いた三次元実装技術と国際標準化活動
23B1-02	3月23日	9:30	10:00	部品内蔵技術	松澤浩彦	株式会社　図研	3Dプリンタを活用した部品内蔵基板の設計製造フロー
23B2-01	3月23日	10:20	10:50	システムインテグレーション実装技術	菊地克弥	産業技術総合研究所	国家プロジェクトにおける3次元集積実装技術の研究開発とシステムインテグレーション技術への展開
23B2-02	3月23日	10:50	11:05	システムインテグレーション実装技術	安達一政	リンテック株式会社	ESD対応バックグラインドテープの開発
23B2-03	3月23日	11:05	11:20	システムインテグレーション実装技術	水嵜英明[1],佐藤彰[2]	長野県工業技術総合センター[1],タカノ株式会社[2]	MEMSプロセスを応用した微細樹脂-Si複合構造体の作製
23C1-01	3月23日	9:00	9:30	材料技術	八甫谷明彦	株式会社ダイセル	ポスト5G／６Gで求められるエレクトロニクス実装材料技術
23C1-02	3月23日	9:30	9:45	材料技術	明石達樹[1],六田充輝[2],西村浩之[3],田中佳典[3]	ダイセル・エボニック株式会社[1],株式会社ダイセル[2],株式会社イノアックコーポレーション[3]	エレクトロニクス分野におけるPEEKとその発泡体の開発
23C1-03	3月23日	9:45	10:00	材料技術	新木直子1,福田匡志2,大場隆之2	株式会社ダイセル[1],東京工業大学[2]	バンプレス接合によるWafer-On-Wafer積層用高耐熱性樹脂の開発
23C2-01	3月23日	10:20	10:35	材料技術	柳浦聡, 原田美由紀	関西大学	反応誘起相分離で形成された液晶を含むエポキシ変性シアネートエステル樹脂の物性
23C2-02	3月23日	10:35	10:50	材料技術	竹中洋登, 鈴木弘世, 中谷晃司	株式会社ダイセル	脂環式エポキシ樹脂の開発及び用途展開
23C2-03	3月23日	10:50	11:05	材料技術	長永昭宏	ポリプラスチックス株式会社	LCPにおけるブリスターに関する最新の知見
23C2-04	3月23日	11:05	11:20	材料技術	カビールムハムドゥル, 蛯谷創, 山城屋陽大, 小原直子	秋田大学	アオコおよび活性汚泥を用いた微生物燃料電池（MFC）の試み
23C3-01	3月23日	11:30	11:45	材料技術	上山椋平, 山崎浩次	三菱電機株式会社	Zn/Agめっきによる焼結Agの接合強度向上メカニズムの検討
23C3-02	3月23日	11:45	12:00	材料技術	江川智哉, 小畑貴慎	株式会社ダイセル	ボイドレス接合用銀ペースト及び新規銅ペースト
23P1-01	3月23日	12:00	13:30	材料技術	涌井洋行, 横山正幸, 中村誠, 米虫治美, 水口伝一朗, 北村幸太	東洋紡株式会社	フレキシブル透明TFT基板等を目指した新規ポリイミドフィルムの開発
23P1-02	3月23日	12:00	13:30	インテリジェント実装設計技術	野口凌平, 古郡葉子, 塚原彰彦, 田中慶太	東京電機大学[1],東京電機大学大学院[2]	超小型IoT衛星搭載用CMG姿勢制御システムの開発
23P1-03	3月23日	12:00	13:30	インテリジェント実装設計技術	佐藤圭, 塚原彰彦, 田中慶太	東京電機大学	超小型IoT衛星搭載用姿勢制御システムの開発
23P1-04	3月23日	12:00	13:30	インテリジェント実装設計技術	松本優樹, 塚原彰彦, 田中慶太	東京電機大学	超小型IoT衛星のコマンド及び衛星軌道情報の送受信システムの開発
23P1-05	3月23日	12:00	13:30	インテリジェント実装設計技術	堀口拓海, 田中慶太, 塚原彰彦	東京電機大学	超小型IoT衛星におけるCommand ＆Data Handlingシステムの開発
24A1-01	3月24日	9:00	9:30	ヘルスケア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス」	野村健一	国立研究開発法人産業技術総合研究所	コンフォーマル印刷による日用品のセンサ化技術と見守り応用
24A1-02	3月24日	9:30	9:45	ヘルスケア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス」	千田優大, 海法克享, 高松誠一, 伊藤寿浩	東京大学	焦電型高精度温度センサアレイに関する研究（第2報）　―駆動時における変形特性の解析―
24A1-03	3月24日	9:45	10:00	ヘルスケア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス」	吉岡凜香	東京大学	嚥下音の非接触計測による嚥下動作解析に関する研究
24A1-01	3月24日	10:20	10:35	ヘルスケア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス」	中尾凌, 田健吾, 南山倖明	東洋アルミニウム株式会社	Al箔を使用したストレッチャブル配線基板
24A2-02	3月24日	10:35	10:50	ヘルスケア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス」	高松誠一, 伊藤寿浩	東京大学	環境調和型生体電極の検討
24A2-03	3月24日	10:50	11:05	ヘルスケア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス」	関根智仁[1],伊藤圭汰[1],庄司宣徳[1],竹田泰典[2],熊木大介[2],SantosFabrice domingues dos[3],宮保淳[4],時任静士[1]	山形大学大学院[1],山形大学ROEL[2],Piezotech株式会社[3], ARKEMA株式会社[4]	機能性高分子を用いたストレッチャブル加速度センサの作製
24A2-04	3月24日	11:05	11:20	ヘルスケア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス」	大塚武	東京大学	伴侶動物の体導搔破音計測用首輪型デバイスのための突起状中間体構造の設計
24A2-05	3月24日	11:20	11:35	ヘルスケア、ウェアラブル、バイオエレクトロニクス」	工藤悠佑, 高松誠一, 伊藤寿浩	東京大学	感情推定のためのマルチモーダルセンシング技術の研究
24A3-01	3月24日	13:00	13:15	配線板とその製造技術	野口裕太	株式会社 ADEKA	エッチング抑制剤を用いた微細回路エッチング
24A3-02	3月24日	13:15	13:30	配線板とその製造技術	眞鍋遼, 立花眞司	上村工業株式会社	電気銅めっき添加剤種における異なるスルーホール径へのフィリング性能とその考察
24A3-03	3月24日	13:30	13:45	配線板とその製造技術	真田昌樹, 今藤桂	新光電気工業株式会社	狭ピッチバンプに対応した最終表面処理の検討とその実装信頼性
24A3-04	3月24日	13:45	14:00	配線板とその製造技術	ATIQAH BINTIJASNI[1],吉原佐知雄[1],斎藤光[1],相木文男[2],渡邉秀樹[2]	宇都宮大学[1],メルテックス株式会社[2]	ピリミジン誘導体を用いたシアンフリー銀めっき浴の電気化学的解析
24A4-01	3月24日	14:20	14:35	配線板とその製造技術	滝沢優哉, 小林慶裕, 種子田浩志, 秋山尚輝, 清水規良	新光電気工業株式会社	ベンダブル性を有する多層ビルドアップ基板への実装技術開発
24A4-02	3月24日	14:35	14:50	配線板とその製造技術	前田侑弥, 山口洋志, 貫名俊介	リンクステック株式会社	マルチワイヤ配線板の高集積化への対応
24A4-03	3月24日	14:50	15:05	配線板とその製造技術	目黒和幸[1], 黒須恵美[1], 石原綾子[1], 鈴木一孝[1,2]	岩手県工業技術センター[1], 岩手大学[2]	分子接合技術(i-SB法)による高周波伝送対応三次元成形回路部品の開発
24A4-04	3月24日	15:05	15:20	配線板とその製造技術	上野翔太郎	秋田県立大学	レーザ誘起プレーティングによる金属パターニングへのパルスレーザ照射条件の影響
24A5-01	3月24日	15:40	16:10	配線板とその製造技術	飯田憲司	富士通インターコネクトテクノロジーズ株式会社	溶融型導電性ペーストによる高多層・高信頼Any Layer IVH基板技術
24B1-01	3月24日	9:00	9:30	カーエレクトロニクス実装	三ノ上勝博	アンシス・ジャパン株式会社	カーエレクトロニクスにおけるシミュレーションでのEMCおよび信頼性評価の最新情報
24B1-02	3月24日	9:30	9:45	カーエレクトロニクス実装	酒井規光	日産自動車株式会社	防湿コート剤の高速・高周波基板への影響調査
24B1-03	3月24日	9:45	10:00	カーエレクトロニクス実装	古賀一成, 中道貴則, 岡和磨, 小林由一	株式会社　図研	パワーモジュール設計で求められる協調設計と構想設計
24B2-01	3月24日	10:20	10:35	電子部品･実装技術	宮田悟志[1],斎藤寛之[2],榎本利章[2]	ダッソー・システムズ（株）[1],ナミックス（株）[2]	格子ボルツマン法CFDによる樹脂注入性解析
24B2-02	3月24日	10:35	10:50	電子部品･実装技術	陳伝伝, 張政, 菅沼克昭	大阪大阪	銀ペーストとセラミックス、半導体との低温無加圧直接焼結接合技術
24B2-03	3月24日	10:50	11:05	電子部品･実装技術	王植[1],芦田喜章[1],青野宇紀[1],宮嶋健太郎[2],有働竜二郎[2],久保田記章[2]	株式会社日立製作所[1],株式会社グローセル[2]	半導体センサチップ単体の温度特性評価手法
24B2-04	3月24日	11:05	11:20	電子部品･実装技術	間嶌亮太	日本電気硝子株式会社	高光取出し効率を実現したUV光源用シール材付きリッドの開発
24B2-05	3月24日	11:20	11:35	電子部品･実装技術	佐藤公俊[1],李治蒙[2]	国士舘大学[1],深圳漢和智造[2]	ガラス基板と異方性導電フィルムの表面冷却式レーザ接合
24B3-01	3月24日	13:00	13:15	高速伝送/回路実装/高周波	長谷川清久[1],山本愛優美[2]	株式会社図研[1],Nexstar[2]	ウェアラブルセンサの試作とエレメカ設計環境を使った構造検討
24B3-02	3月24日	13:15	13:30	高速伝送/回路実装/高周波	岡野太一, 徳田孝太, 梶桂子, 石崎聖和	東芝デバイス＆ストレージ株式会社	大容量3.5型HDDを実現するプリント基板の高密度実装技術
24B3-03	3月24日	13:30	13:45	高速伝送/回路実装/高周波	島嵜睦	三菱電機株式会社	プリント配線板のグラウンドバウンス評価と定式化
24B3-04	3月24日	13:45	14:00	高速伝送/回路実装/高周波	鳥越翔太[1],山本修也[1],保坂亮磨[1],MohamedMansour[1],滝口収[3],村上雅哉[4],金谷晴一[1]	九州大学大学院[1],キオクシア株式会社[2],アルセンス株式会社[3], 株式会社正興電機製作所[4]	無線エネルギーハーベスティング回路の開発及びBluetooth通信実験
24B3-05	3月24日	14:00	14:15	高速伝送/回路実装/高周波	坂本世成, 越地福朗	東京工芸大学	空芯偏平コイルを利用した経皮エネルギー伝送用トランスにおけるコイルの変形に対する伝送特性の検討
24B4-01	3月24日	14:35	14:50	高速伝送/回路実装/高周波	蓮沼栄太朗, 前山利幸	拓殖大学 大学院	ミリ波帯における同軸ケーブルとコネクタの勘合部における緩みによる計算値と実測値の比較に関する研究
24B4-02	3月24日	14:50	15:05	高速伝送/回路実装/高周波	菊地秀雄[1],中島 彩奈[2],茂木和弘[1],白石洋一[1]	群馬大学[1],長野工業高等専門学校[2]	ワイヤレス電力伝送用コイルの交流抵抗を低減する研究
24B4-03	3月24日	15:05	15:20	高速伝送/回路実装/高周波	野末修平, 本木浩之, 田中顕裕	RITAエレクトロニクス	方向性結合器基板を用いた電磁波吸収体のノイズ抑制性能評価
24B4-04	3月24日	15:20	15:35	高速伝送/回路実装/高周波	冨島敦史, 今泉祐介, 宮原秀敏, 阿川謙一, 黒須篤	東芝デバイス＆ストレージ株式会社	半導体EMCモデリング国際規格とその応用
24B4-05	3月24日	15:35	15:50	高速伝送/回路実装/高周波	鈴木美里, 越地福朗, 山田友里, 安田洋司, 山田勝実, 内田孝幸	東京工芸大学	ITO透明導電膜で形成するマイクロストリップ線路の伝送特性の検討
24B5-01	3月24日	16:10	16:25	高速伝送/回路実装/高周波	仙波拓人,桑原堅誠,脇坂俊幸,松嶋徹,福本幸弘	九州工業大学	短波帯広帯域通信における無線通信範囲を制限するアンテナの設計方法
24B5-02	3月24日	16:25	16:40	高速伝送/回路実装/高周波	宮原鼓人[1],タムキムコング[2],石橋毅之[2],金谷晴一[1]	九州大学大学院[1],田中貴金属工業株式会社[2]	磁性体薄膜による28GHz帯単方向スロットアンテナの特性向上に関する研究
24B5-03	3月24日	16:40	16:55	高速伝送/回路実装/高周波	竹上航平, 金谷晴一, 山本駿佑	九州大学大学院システム情報科学府1	ベイズ最適化による28GHz帯単方向スロットアンテナの設計および試作・評価
24B5-04	3月24日	17:10	17:25	高速伝送/回路実装/高周波	佐川哲哉1小牧一郎2大川由貴2小橋泰成2金谷晴一1	九州大学[1],株式会社Braveridge[2]	メイン基板の形状を考慮した2.4GHz帯単方向指向性スロットアンテナの設計
24B5-05	3月24日	17:25	17:40	高速伝送/回路実装/高周波	古川宙磨, 越地福朗	東京工芸大学	4周波遮断帯域を有するUWB用半円台形不平衡ダイポールアンテナの検討
24C1-01	3月24日	9:30	10:00	チュートリアル	羽深等	横浜国立大学大学院	電子機器における電子回路実装の重要性及びパワーエレクトロニクス人材育成
24C1-02	3月24日	10:00	11:00	チュートリアル	八甫谷明彦	よこはま高度実装技術コンソーシアム	プリント配線板のいままでとこれから
24C1-03	3月24日	13:00	13:50	チュートリアル	本多進	よこはま高度実装技術コンソーシアム	電子機器の超高速化やウェアラブル化で半導体デバイス・配線板実装構造が変わる！
24C1-04	3月24日	13:50	14:40	チュートリアル	梶田栄	NPOサーキットネットワーク	たかがコンデンサ　されどコンデンサ
24C1-05	3月24日	15:00	15:50	チュートリアル	髙橋邦明	株式会社　産業分析センター	日本の電子Jisso R&D技術が生き残るには何が必要か？
24C1-06	3月24日	15:50	16:40	チュートリアル	宮代文夫	よこはま高度実装技術コンソーシアム	「ローカル5G」は地方を救う
25A1-01	3月25日	9:00	9:30	光回路実装技術	中村隆宏	技術研究組合光電子融合基盤技術研究所（PETR	「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」プロジェクト（10年間）の研究
25A1-02	3月25日	9:30	9:45	光回路実装技術	寺澤英孝	宇都宮大学	近赤外光励起自己形成光導波路の作製とシリコンフォトニクスへの応用
25A1-03	3月25日	9:45	10:00	光回路実装技術	渡辺要[1],山口祐也[2],菅野敦史[2],多喜川良[1]	九州大学[1],情報通信研究機構光ネットワーク研究所[2]	室温接合により作製されたSi上LN on insulator光変調器
25A2-01	3月25日	10:20	10:35	光回路実装技術	末森大幹[1],石榑崇明[2]	慶応義塾大学大学院[1],慶応義塾大学[2]	鉛直方向垂直曲げコア構造を有するポリマー光導波路の低損失化
25A2-02	3月25日	10:35	10:50	光回路実装技術	長瀬亮[1],上綱秀樹[2],前島寿紀[1],松田竜汰[3]	千葉工業大学大学院[1],株式会社ヨコオ[2],千葉工業大学[3]	ホローコアファイバ用光コネクタ
25A3-01	3月25日	11:00	11:30	光回路実装技術	藏田和彦[1,2]	アイオーコア(株)[1]、I-PEX(株)[2]	2社が共同開発したマイコン内蔵の薄型アクティブ光モジュールと実装技術について
25A3-02	3月25日	11:30	11:45	光回路実装技術	栗澤大河, 紙浦欣輝, 藤川知栄美, 三上修	東海大学	シリコンフォトニクスチップのためのUV硬化樹脂によるテーパ状スポットサイズコンバータのアレイ化
25A3-03	3月25日	11:45	12:00	光回路実装技術	紙浦欣輝, 栗澤大河, 藤川知栄美, 三上修	東海大学	シリコンフォトニクスチップ端面へのポリマースポットサイズエキスパンダーによる高効率光結合の検討
25A4-01	3月25日	13:00	13:15	バウンダリスキャン技術	竹本健太, 土屋秀和, 浅川毅	東海大学	メモリテストに着目したバウンダリスキャンテストシステムの一検討
25A4-02	3月25日	13:15	13:30	バウンダリスキャン技術	土屋秀和, 亀山修一, 浅川毅	東海大学	大学におけるバウンダリスキャン技術に関する教育の取り組み
25A4-02	3月25日	13:30	13:45	バウンダリスキャン技術	馬竣[1],岡本悠[1],王森レイ[1],甲斐博[1],亀山修一[1],高橋寛[1],清水明宏[2]	愛媛大学[1],高知工科大学[2]	JTAG認証機構の軽量化設計について
25A4-03	3月25日	13:45	14:00	バウンダリスキャン技術	片山翔太, 有元康滋, 四柳浩之, 橋爪正樹	徳島大学	TDC組込型バウンダリスキャンの遅延信号観測対象判別回路の設計
25A5-01	3月25日	14:20	14:35	インテリジェント実装設計技術	木村勇介, 茂木和弘, 白石洋一	群馬大学	シングルボードマイコンを用いた，製造工程デジタル化ための非接触型IoT機器の開発
25A5-02	3月25日	14:35	14:50	インテリジェント実装設計技術	吉澤大, 白石洋一, 茂木和弘	群馬大学大学院	深層学習とステレオカメラを用いたバラ積みピッキングシステムの開発
25A5-03	3月25日	14:50	15:05	インテリジェント実装設計技術	秦麟一郎	東京電機大学院	デジタルツインを用いた遠心ポンプのシミュレーションモデルに関する基礎検討
25A5-04	3月25日	15:05	15:20	インテリジェント実装設計技術	中島彩奈[1],奥浩之[2],茂木和弘[2],白石洋一2	長野工業高等専門学校[1],群馬大学[2]	害獣認識システムにおける天候対応可能な検出手法の検討
25A6-01	3月25日	15:40	15:55	インテリジェント実装設計技術	高橋彰人[1],田中元志[1],室賀翔[1],新山喜嗣[1],王建青[2]	秋田大学[1],名古屋工業大学[2]	運動想起時脳波の機械学習による手の開閉動作判別に関する一検討
25A6-02	3月25日	15:55	16:10	インテリジェント実装設計技術	水村友紀, 塚原彰彦, 田中慶太	東京電機大学	生体情報の時系列データにおける数値表現の基礎的検討
25A6-03	3月25日	16:10	16:25	インテリジェント実装設計技術	渡邉恭佑, 白石洋一, 茂木和弘	群馬大学大学院	強化学習に基づく清掃ロボットの経路計画手法
25A6-04	3月25日	16:25	16:40	インテリジェント実装設計技術	齊藤龍一, 白石洋一, 茂木和弘	群馬大学	ロボット芝刈り機の制御における深層学習を用いた作業面の認識
25A7-01	3月25日	17:00	17:15	インテリジェント実装設計技術	佐々木太地, 室賀翔, 鴨澤秀郁, 田中元志	秋田大学	MSLの近傍磁界マップの機械学習によるループ電流モデルの寸法パラメータ抽出に関する一検討
25A7-02	3月25日	17:15	17:30	インテリジェント実装設計技術	白水博[1],丹正淳文[2],勝山ちひろ[1],峯孝太郎[1],小川正太郎[1]	パナソニック　スマートファクトリーソリューションズ株式会社[1], 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社[2]	プラズマモニターを用いたプラズマクリーナーにおける予防保全
25A7-03	3月25日	17:30	17:45	インテリジェント実装設計技術	李俊澤, 茂木和弘, 白石洋一	群馬大学	機械学習を用いた自動外観検査の精度を向上する画像処理手法に関する研究
25A7-04	3月25日	17:45	18:00	インテリジェント実装設計技術	本田真吾[1],李俊澤[2],白石洋一[2],茂木和弘[2],篠崎義昭[1]	（株）ヨコオ[1],群馬大学[2]	物体検出にもとづくプローブ先端外観検査実用化のためのデータセット水増し条件最適化に関する検討
25B1-01	3月25日	9:00	9:20	設計技術	小林由一,中道貴則,牧原孝史, 西元良匡	株式会社図研	全体最適を可能にするCR-8000 MEMS Designer のご紹介
25B1-02	3月25日	9:20	9:40	プロセス技術	中川翔太, 江田哲朗, 白井友貴, 岸本一喜	株式会社JCU	高面均性ビアフィリングめっきプロセス
25B1-02	3月25日	9:40	10:00	プロセス技術	松井康介[1],三宅裕子[1],鳥成優一郎[1],渡口繁[2],北村朱里[2],渡邊秀樹[2],清水智弘[3],新宮原正三[3],元吉真[4]	株式会社東設[1],メルテックス株式会社[2],関西大学[3], 東北マイクロテック株式会社[4]	Φ8インチ極深孔TSV基板への無電解バリアシードめっき膜の形成
25B2-01	3月25日	10:20	10:40	検査・試験・信頼性評価技術	森本裕一,西川太平,菊池郁織,田中浩和	エスペック株式会社	新たな伝熱方式を用いた熱的環境中の電子基板の各種特性評価
25B2-02	3月25日	10:40	11:00	部品、各種ICパッケージのほか、パワー素子、LEDランプ、太陽電池、二次電池、燃料電池、ディスプレイ（LCD、有機ELほか）等	長野英晃,君島孝一	株式会社ADEKA	リチウムイオン二次電池用グラフェン分散液の開発
25B3-01	3月25日	13:00	13:30	マイクロメカトロニクス実装技術	千葉大地	大阪大学・産業科学研究所	フレキシブル基材上に形成したスピントロニクス素子によるひずみセンシング
25B3-02	3月25日	13:30	13:45	マイクロメカトロニクス実装技術	野上大史	九州大学	ハクビシンにおける非侵襲脈拍計測技術の開発
25B3-03	3月25日	13:45	14:00	マイクロメカトロニクス実装技術	森田伸友, 岩崎渉	産業技術総合研究所	血栓検出用小型光センサの高感度化
25B4-01	3月25日	14:20	14:35	マイクロメカトロニクス実装技術	安藤弘道, 生津資大	京都先端科学大学	FIB技術に基づく2種類のSiナノ細線の機械物性アニール効果の比較
25B4-02	3月25日	14:35	14:50	マイクロメカトロニクス実装技術	松前貴司[1], 倉島優一[1], 高木秀樹[1], 白柳裕介[2],檜座秀一[2],西村邦彦[2], 日暮栄治[1]	産業技術総合研究所[1], 三菱電機株式会社[2]	表面活性化接合によるナノレベル中間層を介したGaN/ダイヤモンド常温接合
25B4-03	3月25日	14:50	15:05	マイクロメカトロニクス実装技術	松前貴司, 倉島優一, 高木秀樹, 梅沢仁, 渡邊幸志, 伊藤利充, 日暮栄治	産業技術総合研究所	ダイヤモンドとの直接接合を用いたβ-Ga2O3超ワイドギャップ基板の高放熱化
25B4-04	3月25日	15:05	15:20	マイクロメカトロニクス実装技術	藤野真久[1]髙橋健司[1],菊地克弥[1],宮田登[2],宮崎司[2]	産業技術総合研究所[1],総合科学研究機構 中性子科学センター[2]	中性子反射率法による酸化膜ウエハ接合界面における水分の解析
25B5-01	3月25日	15:40	15:55	マイクロメカトロニクス実装技術	若本恵佑1大塚拓一1中原健1生津資大2	ローム株式会社1京都先端科学大学2	熱サイクル負荷による銀焼成接合層の破壊メカニズム
25B5-02	3月25日	15:55	16:10	マイクロメカトロニクス実装技術	安木大恭[1],前川夏菜[2],児玉健太[1],三宅修吾[3],生津資大[1]	京都先端科学大学[1],愛知工業大学[2], 神戸市立工業高等専門学校[3]	高靭性Al/Ni発熱反応膜を用いた瞬間接合体のクラック形成に関する研究
25B5-03	3月25日	16:10	16:25	マイクロメカトロニクス実装技術	高倉亮[1,2], 渡辺要[1], 多喜川良[1]	九州大学[1],日本電産マシンツール株式会社[2]	原子層堆積法で成膜した酸化アルミニウム極薄膜同士の常温接合
25B5-04	3月25日	16:25	16:40	マイクロメカトロニクス実装技術	前川敏輝, 範云翰, 渡辺要, 多喜川良	九州大学	表面活性化によるInPとSiCの室温ウェハ接合